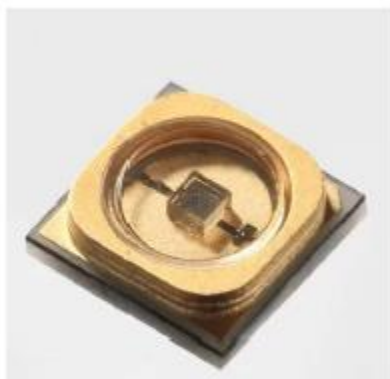


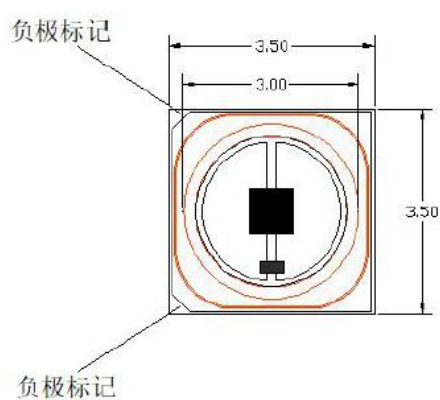


SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-UVC275-6V150



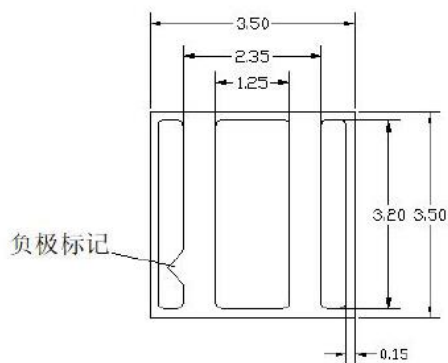
外形尺寸：（单位：mm，公差±0.1mm）



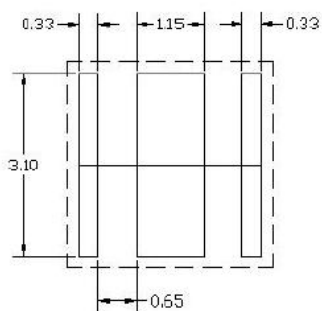
俯视图



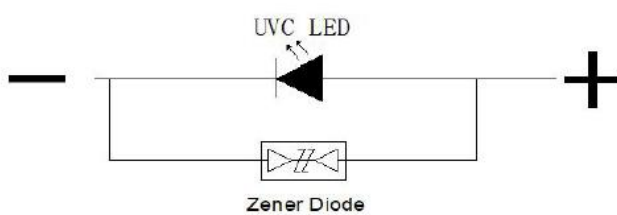
侧视图



底部焊盘（透视图）



推荐钢网尺寸





光电特性 （Ta = 25℃）

参数	测试条件	符号	最小值	典型值	最大值	单位
峰值波长	If=150mA	λ_p	270	275	280	nm
输出辐射功率		P_{opt}	10	12		mW
正向电压		V_f	5		7.5	V
半高宽		$\Delta\lambda$	--	9	--	nm
发光角		$2\theta_{1/2}$	--	120	--	°
热阻 (Tj-Tsp)		Rth	--	11	--	°C/W

说明：Tc=25℃；正向电压公差：±0.1V；辐射通量公差：±8%；峰值波长公差：±3nm。

极限使用条件：

项目	符号	单位	范围
正向电流	If	mA	≤300
结温	Tj	℃	≤90
工作温度	Topr	℃	-30-60
焊接条件	Tsol	-	260℃ < 5 秒



SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-UVC275-6V150

光电参数曲线：

Fig.1 Relative Radiant Power VS Forward Current

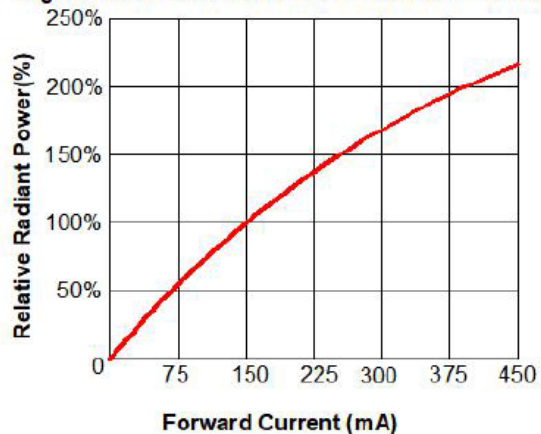


Fig.2 Forward Current VS Forward Voltage (Ta=25℃)

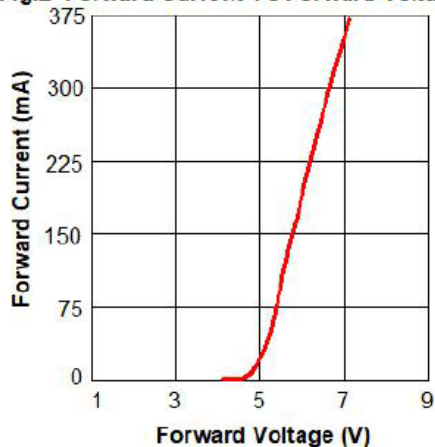


Fig.3 Forward Voltage VS Ambient Temperature

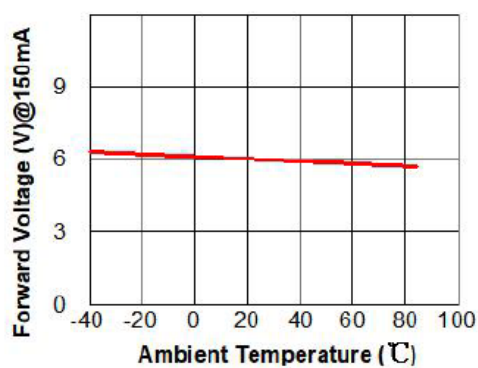
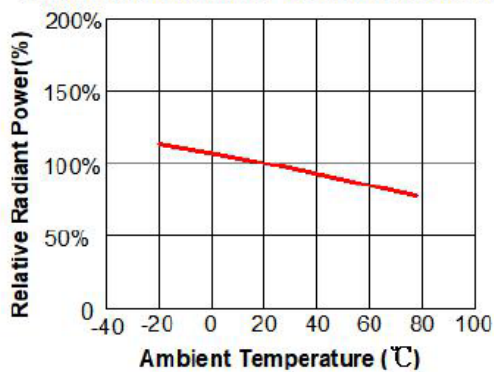


Fig.4 Relative Radiant Power VS Ambient Temperature





SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-UVC275-6V150

Fig.5 Peak Wavelength VS Forward Current

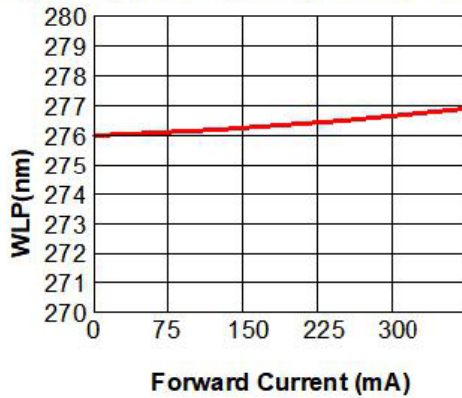


Fig.6 Forward Current VS Ambient Temperature

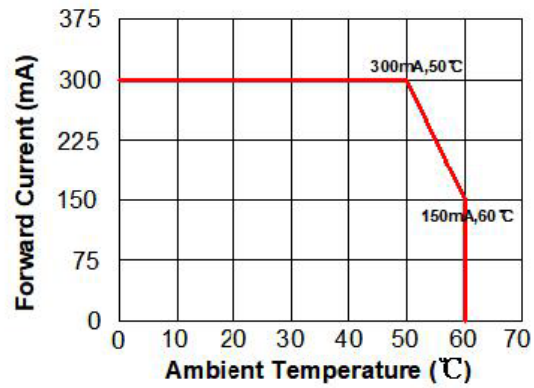


Fig.7 Relative Intensity VS WLP

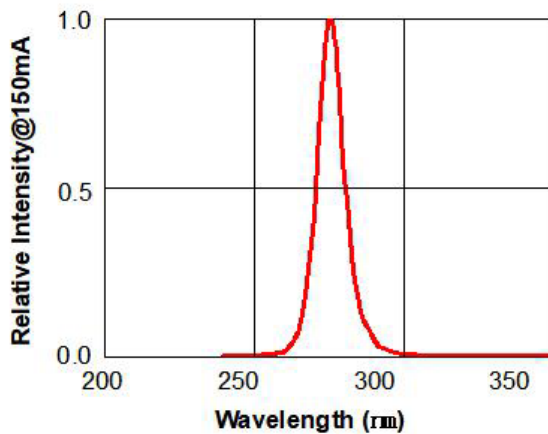
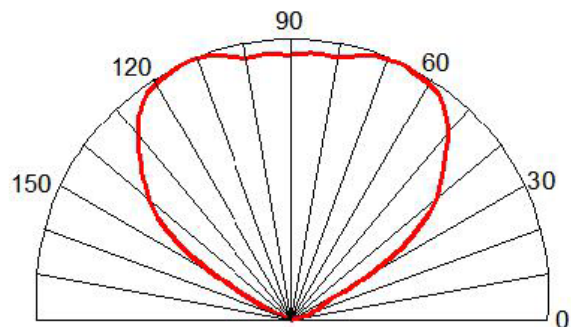


Fig.8 Radiation pattern@150mA



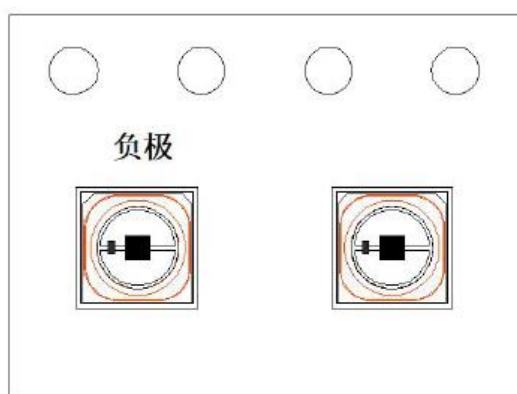
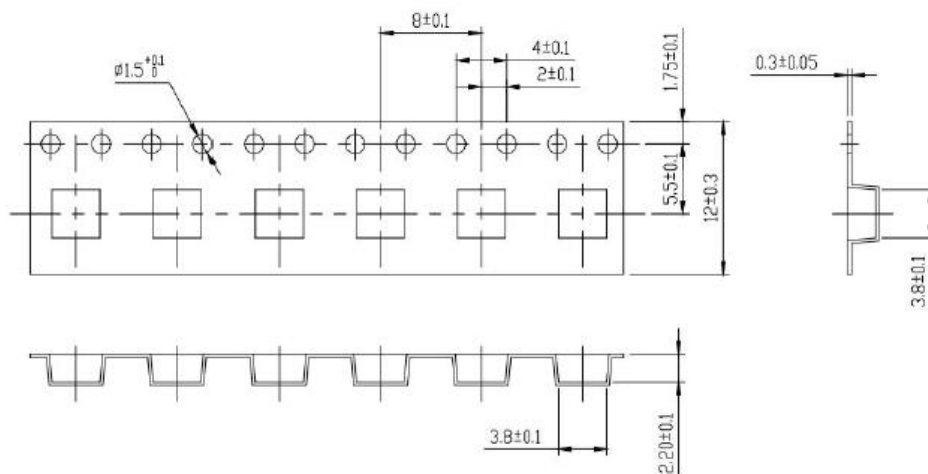


SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

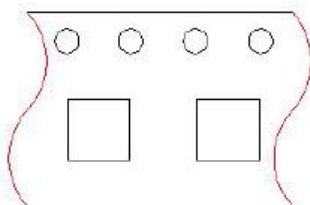
Part No: SEL-3535-UVC275-6V150

包装规范

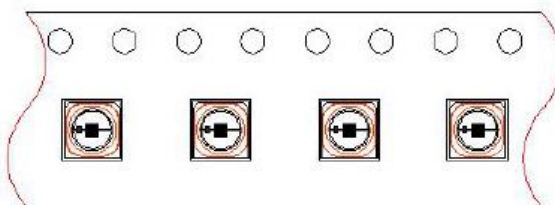
(单位: mm)



末端

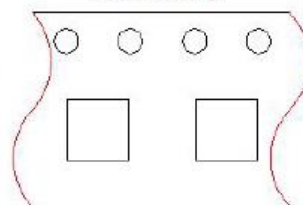


200mm空载带



每卷1000PCS

进料方向



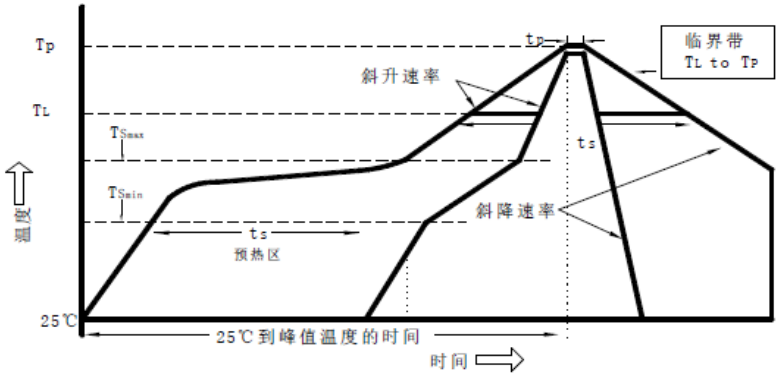
400mm空载带



可靠性测试

项目	条件	失效判据
常温寿命测试	25°C, 150mA, 1000 小时	正向电压, $V_f > 120\%$
高温存储	100°C, 1000 小时	
低温存储	-40°C, 1000 小时	
温度循环 (100 次)	-40°C (30mins) ~ +25°C (5mins) +100°C(30mins) ~ +25°C (5mins)	辐射功率, $P_{opt} < 70\%$

推荐回流焊温度曲线



温度分布特点	无铅焊料
斜升速率 (T _{Smax} 到 T _P)	最大值 1°C/秒
最低预热温度 (T _{Smin})	100°C-150°C
最高预热温度 (T _{Smax})	180°C-200°C
预热时间 (T _{Smin} 到 T _{Smax})	60-120 秒
液相温度 (T _L)	217°C
温度维持在 T _L 以上时间	50-80 秒
封装体峰值温度 (T _P)	260°C
指定实际峰值温度 5°C 内的时间	20-40 秒
斜率速率 (T _P 到 T _L)	最大值 3°C/秒
25°C 到峰值温度的时间	最大值 4 分钟